证券代码：300054　　证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261120

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	2026 年 11 月 20 日下午 14:30~16:30：幸福人寿：何六艺，生命资产：杨文虎，银华基金：刘晓雅、刘芳、贺婷、邹正国、丁林慧、郑中方、兰健、郭淳、何纯、游姗姗、庞师兰、安然、关健、梁宇奇、王心宜、曾淑琴、王娜、吴竟、冯芳、李鑫、柏漪雯、王海波、孙楚晴、王艺霖、郭超、王嘉欣、余天与、梁超然、孙晨、李响、陈宇善、张培博、方锦仪、刘伦、罗敏敏、李兵宇、陈星连、韩廷宾、孙抒逸、徐晓立、高歌、王鑫等，共 80 名投资者及证券人员
时间	2026 年 11 月 20 日下午 14:30~16:30
地点	公司 6 楼多功能厅
上市公司接待人员姓名	2026 年 11 月 20 日下午 14:30~16:30：投资者关系总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	**公司介绍：** 鼎龙股份是国内领先的以半导体材料为核心的创新材料平台型公司。公司产品覆盖集成电路制造、先进封装、半导体显示等多个细分领域；同时拓展锂电关键功能性辅材，发力新能源赛道，并持续在其他重点应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外，公司积极开拓成熟材料产品的海外市场，同步推进国际一流水平的前沿材料研发，致力于成为全球化创新材料平台标杆。 **问 1：公司抛光垫的新品和新客户拓展情况如何？** **答：**公司是国内 CMP 抛光垫核心供应商，已建成配套的抛光垫生产基地，具备规模化稳定供货能力。公司 CMP 抛光垫业务坚持产品迭代与市场拓展双线推进，整体保持着不断增长的良好态势。硬垫品类上，面向更高端制程的配套抛光垫持续开展配方与工艺迭代优化，产品出货规模及营收占比稳步提升，国内市场领先地位持续巩固；针对海外及国内外资晶圆制造客户，公司有序推进送样、评估及验证流程，多家外资晶圆厂已进入测试验证阶段，部分客户形成初步合作意向。软垫品类上，在深耕传统晶圆制造客户的基础

	上，积极拓展多元化应用赛道，面向大硅片、碳化硅、先进封装 TSV、2.5D/3D 封装、板级玻璃基板封装等新兴场景持续开发适配新品。其中玻璃基板专用软抛光垫已向多家头部客户送样验证，并顺利获得板级封装领域重点客户订单，实现先进封装应用场景的商业化突破。公司将持续投入研发优化产品性能，同步配套推进产能建设，稳步加快新品认证、客户导入节奏，把握半导体材料国产替代机遇，持续扩大产品应用覆盖面与市场渗透率。 **问 2：公司光刻胶在客户端的订单转化情况如何？** **答：**公司 ArF、KrF 高端晶圆光刻胶依托国内首条覆盖有机合成、高分子聚合、高纯精制、光刻胶混配一体化全流程量产产线开展产业化推进，核心树脂、光酸等关键原料实现自研自产，为客户端验证及订单转化筑牢基础。截至目前，公司已有 10 款高端晶圆光刻胶取得国内多家主流晶圆厂批量订单，产品已在客户量产产线稳定落地、持续交付；公司累计规划开发 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款产品已向多家晶圆制造客户送样验证，其中超 10 款进入加仓样测试阶段，另有多款产品持续推进多轮工艺评估，预期后续逐步完成订单转化。配套材料层面，公司同步布局 BARC、SOC 等光刻配套辅材，与主光刻胶协同开展客户端验证，为客户提供一体化光刻耗材解决方案。产能端，潜江一期年产 30 吨产线稳定运行，持续保障样品及小批量订单交付；二期年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶量产产线已投产，现阶段处于有序爬坡阶段，公司优先保障已落地订单的排产交付，持续提升产线稼动水平。公司将持续跟进客户端测试反馈，依托自研原料与配方一体化平台快速迭代优化产品良率、缺陷控制等关键指标，持续推进在测型号的验证落地与订单转化，稳步扩大在头部晶圆厂的供货品类与份额。 **问 3：请问抛光液的竞争优势如何？** **答：**CMP 抛光液、清洗液为公司半导体材料板块重要增长极，目前已实现抛光液全品类布局，铜制程抛光液、金属栅极（钨、铝）抛光液、多晶硅、氮化硅抛光液、介电层抛光液、氧化铈抛光液、大硅片精抛液、TSV 抛光液、SiC 衬底抛光液等多品类实现销售，同步配套布局多款 CMP 后清洗液产品，产品矩阵不断丰富。除此之外，公司抛光液自产研磨粒子搭载率已超 80%，自主供应链优势持续巩固。公司 CMP 抛光液与抛光垫形成协同布局，依托在 CMP 材料领域长期积累的材料配方、界面机理、工艺匹配、验证服务等一体化技术能力，构建差异化竞争基础。一方面，抛光液与抛光垫具备配套协同开发优势，可面向客户不同制程、不同膜层需求开展联合工艺调试，能够更快响应晶圆厂的工艺定制化需求，缩短客户验证周期；另一方面，公司持续加大抛光液研发投入，覆盖集成电路、先进封装、第三代半导体等应用场景，同步推进产线建设，逐步形成稳定的规模化供货能力。同时，公司深度绑定国内主流晶圆制造客户，伴随客户产线扩产与国产替代进程，持续推进多品类抛光液的送样、验证及导入工作。后续公司将持续打磨产品稳定性、批次一致性，持续提升配套服务能力，夯实长期竞争基础。 **问 4：公司自产的研磨粒子在抛光液快速上量后有哪些优势？**

	答：公司自研自产研磨粒子是抛光液核心原料的重要布局，目前已完成相关技术开发与配套产线建设，可实现对抛光液核心原料的自主供给。在抛光液业务快速上量后，自产研磨粒子将形成多维度竞争优势：第一，有利于实现供应链自主制备，降低对外购核心原料的依赖，规避外部原料供给波动、交付周期、价格变动带来的经营风险，保障抛光液业务长期稳定供货，公司已完成超纯硅、高纯硅、氧化铝、氧化铈四大类 CMP 抛光液核心研磨粒子的完整布局，仙桃园区配套建设万吨级研磨粒子产线，具备规模化稳定供给能力；伴随下游晶圆制造、先进封装等领域对抛光液的工艺、技术要求持续提升，同时下游市场对更高端制程的需求持续扩张，公司将依托一体化协同研发与配套供应优势，稳步放大产业链协同价值；第二，具备配方协同优化优势，研磨粒子的粒径、形貌、表面特性等关键指标可结合抛光液体系、抛光垫产品、客户工艺需求同步定制开发，实现粒子、抛光液、抛光垫三者之间的工艺匹配协同，更高效满足不同膜层、不同制程的抛光指标要求，助力缩短客户验证周期；第三，有助于成本精细化管控，随着抛光液出货规模持续提升，研磨粒子自产业务将发挥规模效应，优化抛光液整体成本结构，不断优化产品盈利弹性；第四，便于持续迭代技术，依托粒子合成到抛光液配方、工艺验证一体化研发平台，能够快速迭代新品方案，持续改善抛光速率、表面粗糙度、缺陷控制等核心性能指标，支撑抛光液多品类、多场景拓展。公司将持续推进自产研磨粒子与抛光液业务的配套开发，稳步放大协同价值。 **问 5：公司在玻璃基板技术相关领域有哪些产品布局？** **答：**公司前瞻性布局先进封装玻璃基板配套 CMP 材料赛道，自主研发的玻璃基板专用软抛光垫已取得阶段性商业化突破，成功获取板级封装领域重点客户订单，正式导入玻璃基板载体的板级封装产线。玻璃基板脆性更高，对抛光后的全局平坦度等指标要求严苛，公司围绕该应用场景形成系统性产品布局：核心产品为玻璃基板专用软抛光垫，针对玻璃基材特性开发专属配方和产品结构，可适配 TGV、光电共封装等高密度互连工艺需求；同步配套推进适配先进封装抛光场景的抛光液开发，依托自研自产研磨粒子、抛光液、抛光垫一体化协同研发平台，可为客户提供整套 CMP 耗材解决方案，有利于缩短客户联合工艺调试与验证周期。产能端，公司在潜江规划建设第三条软抛光垫产线，重点面向玻璃基板 CMP 抛光垫及大尺寸抛光垫，匹配下游中长期订单需求；现有软垫产线同步承担送样、小批量供货任务，持续保障客户验证节奏。市场拓展层面，玻璃基板专用软抛光垫已向多家头部封测、晶圆制造客户送样验证，持续跟进不同规格、不同工艺平台的测试反馈，根据客户工艺需求持续迭代优化产品性能。公司将持续紧跟 HBM、TSV 等先进封装技术发展趋势，稳步推进产品验证、订单转化与产能建设，把握玻璃基板配套 CMP 材料的发展机遇。 **问 6：公司新能源材料目前的进展和增速如何？** **答：**皓飞新材为国内锂电分散剂细分领域头部企业，自 2026 年 3 月

	纳入公司合并报表以来，业务拓展与产能建设有序推进，整体保持较快增长态势。产品矩阵方面，现已形成以锂电分散剂、粘结剂、多品类功能助剂为核心的布局，适配下游主流及新一代电池技术路线，新一代分散剂已顺利导入国内头部动力电池、储能电池客户并实现稳定供货，产品结构持续优化；市场拓展层面，在深耕国内优质电池客户的同时稳步推进海外布局，已实现对海外客户的小批量出货。增速方面，2026 年 3 月至 9 月并表区间，锂电功能性辅材业务实现销售收入 4.63 亿元，同比增长 60%，其中第三季度收入同比增长 58.81%、环比增长 16.89%，增长态势稳健。产能端，仙桃产业园扩产项目有序落地，新增产线将逐步释放产能，支撑头部客户持续放量以及新客户、新品类的验证交付需求。研发端，公司联合皓飞新材围绕行业痛点持续开展前沿材料开发，协同国内头部电池企业攻关多款面向电池安全、热管理、电性能及能量密度提升的创新型锂电功能材料，为后续增长储备动能。依托公司平台化材料研发、供应链及内控管理能力，后续将持续推进客户结构丰富、品类延伸与海外市场拓展，把握动力电池与储能行业发展机遇。
附件清单	无
日期	2026 年 11 月 20 日